

2024国际半导体产业及应用展览会-半导体材料展会参展申请入口

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 2024国际半导体产业及应用展览会- 半导体材料展会参展申请入口 |
| 公司名称 | 中国（耀瀚）展会信息 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 |
| 联系电话 | 17810353883 17810353883 |

产品详情

2024第6届深圳国际半导体技术展览会展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

作为华南的半导体行业盛会，2024第6届深圳国际半导体技术展览会以半导体产业为依托，全面展示国内外半导体新产品、前沿技术成果和解决方案。博览会将进一步发挥经济圈产业优势，挖掘市场发展机遇，促进产业链深度交流合作，创新培育科技化、化、国际化的半导体互动平台，推动中西部、西南地区半导体产业高质量创新发展。

SEMI-e以“芯机会?智未来”为主题，汇聚众多和学者，进一步加强全球集成电路产业的交流与合作，围绕中国国际集成电路产业与应用，立足深圳、辐射全国，旨在集中展示集成电路产业发展成果，加快高端芯片设计、关键器件、核心装备材料、EDA设计工具等产业链关键环节攻关突破，加强珠三角产业链协作，逐步形成综合性集成电路产业集群，打造华南集成电路产业交流与贸易平台，推动华南集成电路产业集聚区更快更好发展。本届展会顺应产业发展趋势，服务于十几个新兴行业应用。

三、展览范围

博览会以客户需求为导向，整合上中下游产业链资源，为展商与观众、caigou团提供合作交流契机。2024年，展区设置更加精细化、化，呈现半导体产业成果与区域风采，促进西部地区半导体产业创新融合发展。

IC设计专区：

EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计等；

集成电路制造专区：

晶圆制造厂、晶圆代工厂、模拟集成电路、数字集成电路和数、模混合集成电路制造等；

封装测试专区：

测试探针台、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝等；

半导体材料专区：

硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料等；

设备制造专区：

减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备、切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台、洁净室设备等；

电子元器件专区：

电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶（带）制品、电子化学材料及部品等；

AI+5G专区：

工业互联网平台、智能机器人、智能汽车、智能手机、智能交通、航天航空电子、智能家电、无人机、5G开发及应用、多接入边缘计算、网络切片、虚拟技术、医疗电子等；

智慧电源专区：

微波射频、半导体LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等；

zhengfu、产业园专区：

全国各地zhengfu组团及半导体相关领域高科技产业园区等。

基本概况

时间：2024年6月26日-28日

地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

主题：SEMI-e以“芯机会?智未来”为主题

规模：55000展出面积（m²）

展商：800+企业（家）

观众：80000+观众（名）